

認証書付属書

表1 認証試験板厚の溶接条件データ
(最小及び最大ルート間隔の場合)

板厚 (mm)	最小、最大 ルート間隔 (mm)	溶接電流範囲 (A)	溶接電圧範囲 (V)	溶接速度範囲 (c p m)	パス数
32	4	201~260	26~31	26.4~45.0	19
	10	195~260	26~30	28.6~45.0	26

定常状態の溶接条件データ測定値を記載している。

表2 認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲

板厚 (mm)	最小、6mm、最大 ルート間隔 (mm)	溶接電流範囲 (A)	溶接電圧範囲 (V)	溶接速度範囲 (c p m)	パス数
25	4	200~280	26~33	25~45	13
	6	200~280	26~33	25~45	15
	10	200~280	26~33	25~45	19
28	4	200~280	26~33	25~45	14
	6	200~280	26~33	25~45	16
	10	200~280	26~33	25~45	19
32	4	200~280	26~33	25~45	19
	6	200~280	26~33	25~45	20
	10	200~280	26~33	25~45	25
36	4	200~280	26~33	25~45	23
	6	200~280	26~33	25~45	26
	10	200~280	26~33	25~45	32
40	4	200~280	26~33	25~45	29
	6	200~280	26~33	25~45	32
	10	200~280	26~33	25~45	41

パス数は、表2に記載の10%増までのパス数を認める(小数点以下は切上げ)。

角形鋼管と通しダイアフラムの場合は直線部の溶接施工条件範囲を記載している。

※この溶接施工条件範囲は、認証された溶接条件(30kJ/cm以下、パス間温度250℃以下)で使用しなければならない。